

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	彬元资本、华福证券、天弘基金、国信证券、交银施罗德、兴业证券、APS Asset Management、马来西亚国库控股、施罗德基金、光大控股、上海信托
时间	2024年6月17日(周一) 下午 16:00~17:30 2024年6月18日(周二) 下午 16:00~17:30 2024年6月19日(周三) 下午 15:30~17:00 2024年6月20日(周四) 上午 10:00~11:30
地点	深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司今年推出的 CXL 2.0 内存拓展模块及 LPCAMM2 等产品的技术优势及应用场景？</p> <p>答：随着 AI 的快速发展，计算密集型工作负载对存储的低延迟、高带宽提出了前所未有的高要求。Compute Express Link® (CXL®) 互连技术为数据中心的性能和效率提升开辟了新的途径。公司今年推出了首款采用自研架构设计，FORESEE CXL 2.0 内存拓展模块，基于 DDR5 DRAM 开发，支持内存池化共享，为企业级应用场景带来全新突破。该产品通过独特堆叠技术，能够基于 16Gb SDP 颗粒实现 128GB 大容量，相比业界同期水平实现成本大幅度下降的优势。CXL 2.0 内存拓展模块有望在高性能计算领域发挥越来越重要的作用，并推动存储行业和数据中心的技术进步和创新发展。</p> <p>同时，公司今年发布了 FORESEE LPCAMM2，以其独特的 128bit 位宽设计，实现了内存形态的新突破，有望打通 PC 和手机存储应用场景。LPCAMM2 这一创新形态为 AI 终端、商用设备、超薄笔记本等对小体积有严格要求的应用场景带来了性能和能效的明显提升。未来，FORESEE LPCAMM2 内存产品的容量将随着技术发展和客户需求而逐步提升。</p> <p>目前，FORESEE CXL 2.0 内存拓展模块与 LPCAMM2 产品均已做好全面量产的准备，将有序投入生产制造。</p> <p>2、今年公司各产品线营收占比是否会有变化？</p> <p>答：嵌入式存储业务依然是公司主力，是销量及毛利的主要贡献来源；典型的移动存储业务将保持稳定的业务占比；基于公司企业级存储产品的推出，叠加信创行业复苏所带来的双重驱动，今年公司固态硬盘业务占比将呈现稳步上升的趋势；最后是内存条业务，今年其营收占比预计保持稳中有升。</p>
---------------------------	---

3、公司自研小容量存储芯片进展情况？

答：公司 SLC NAND Flash 存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿戴、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用领域，累计出货量已超过 5000 万颗。目前公司与这些主要应用领域的头部客户都已经建立了稳定的合作关系，与此同时还在国际穿戴品牌客户中取得了突破，成功导入了其旗舰产品。此外，在高可靠性的工业自动化、车载应用中公司也取得了 0 到 1 的突破。

公司自研存储芯片业务的顺利推进，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力，形成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争优势。

4、如何看待晶圆价格走势？

答：目前原厂供应向企业级产品倾斜，整体存储晶圆的供应依然偏紧；其次，在价格上，原厂拉涨价格的态度目前较为坚决。各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。

5、公司目前具备的差异化竞争优势有哪些？

答：在核心技术方面，公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可实现量产。另一方面，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已批量应用），并匹配自研固件算法，能够高效率满足客户，特别是大客户的产品性能要求，并且在售后服务故障解决等领域快速解决问题，最终明显增加大客户黏性。

封测制造方面，公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购，这是加强全球供应链布局，进一步开

拓海外市场的重要举措，有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。

品牌优势方面，公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司经过十多年的技术积累，打造了 FORESEE 品牌并在存储行业拥有良好的口碑；Lexar（雷克沙）是大陆地区为数不多的，拥有全球市场影响力的消费类高端存储品牌。

6、如何看待 eMMC 向 UFS 迭代趋势？公司在 UFS 相关领域进展如何？

答：随着 eMMC 向 UFS 的迭代，公司在市场上已具备一定的先发优势，持续多年投入对 UFS 新一代嵌入式存储、集成式嵌入式存储（即 ePOP、eMCP 等）的研发。目前，公司的 UFS 2.2 和 UFS 3.1 产品已经量产，公司 UFS 新一代存储器产品均采用公司自主研发固件，能够快速响应及解决来自不同细分市场的需求，为客户提供传输速率更高、容量更大的存储方案，保证公司在 eMMC 向 UFS 过渡关键时点仍然拥有领先的市场地位及技术优势。

7、晶圆涨价对公司毛利率的影响？

答：因晶圆采购与产品销售之间存在周期间隔，晶圆价格上行将对公司毛利率产生一定正面影响。公司 2024 年第一季度实现了 24.39%，目前公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响，公司将不断进行产品结构的优化。

8、公司目前的库存策略？

答：公司采用以需求为基本牵引，结合市场综合因素判断的采购策略。公司 2024 年一季度营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.52%，随着公司整体销售规模的不断增长，公司存货金额也会相应增加；与此同时，公司大客户

有所新增（如 OPPO 等），大客户非常关注公司持续供应能力，公司相应增加备货；此外，从目前行业来看，参与各方（包括公司在内）均认为存储晶圆的价格在未来一段时间内将保持上涨的态势，公司存货的备货策略也会与下行周期有所差异。

9、公司与各原厂的合作关系如何？

答：公司均向上游主要存储晶圆原厂直接采购，双方建立了长期、稳定和紧密的业务合作关系并签署了长期合约，确保持续存储晶圆供应的稳定性。

10、公司未来是否会布局 HBM 业务？

答：HBM 技术涉及到公司上游，即存储原厂内存芯片设计技术、晶圆级堆叠技术等不同环节的技术复合型应用，目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂（如 SK Hynix，三星等）为主导甚至是存储原厂自行完成封装。目前公司子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装（HBM 技术涉及的一部分）的量产能力，但目前无法生产 HBM。

11、元成苏州及 Zilia 的未来发展规划？

答：作为公司加强生产制造端布局的具体措施，元成苏州在继续承接现有客户群体的封测委托外发业务之外，还将进一步成为公司整体业务的封装测试基地，提高公司在封测和制造上的能力，满足客户交付保障的要求，其产能利用率将不断增长。

Zilia 的收购作为公司加大海外市场开拓的具体举措，公司将以自身的技术与产品设计方案为 Zilia 赋能，发挥 Zilia 贴近本地客户、自研技术、综合存储产品、本地制造的优势，为海外客户提供更优质的服务，扩大公司的海外市场份额，并为公司国际业务的中长期发展起到基础性作用

12、公司在信创行业的收入体量及进展情况？

答：公司暂时未单独统计在信创行业的收入。公司对党政信创、行业信创并重。在党政信创领域，公司主要与下游大型 OEM 整机厂积极配合。在行业信创领域，目前看到以电信运营商为代表的部分行业信创市场有所起色，预计今年会有更多新增需求。信创市场对应公司的主力产品线集中在企业级存储业务，由于行业信创涉及到每一个采购主体各自的采购程序，包括采购程序之前的产品验证导入的过程，因此在前两年企业级产品完成验证程序的基础上，公司未来在信创行业将迎来更多的参与机会。公司企业级存储业务在今年预计会有一定受益。

13、公司主控芯片业务的进展情况？

答：公司两款自研主控芯片（WM 6000、WM 5000）已经批量出货，赋能公司 eMMC 和 SD 卡两大核心产品线，并已经实现了数千万颗的规模化产品导入，助力公司中高端存储器产品固件算法自研的竞争优势，进一步增强公司整体竞争力以及产品技术护城河。

14、公司未来的人员扩张计划？

答：目前公司研发体系的各个核心板块，如自研主控、自研存储芯片、封装测试、固件开发，以及存储器设计能力等，均已基本搭建完善，因此预计公司未来的人员扩张将更加体系化以及精细化。

15、公司在 OPPO 的出货量预计有多少？

答：依据市场机构的数据，OPPO 整体的采购需求市场规模较大。

16、公司企业级存储业务进展，其营收今年大概在什么水平？

答：公司是国内少有的 eSSD 和 RDIMM 两类产品协同发展的企业，其中公司 eSSD 已经在多个核心客户处完成了认

证和量产，广泛应用于通信、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质量评价；RIDMM 方面，公司已经完成了从 16G 到 96G 所有主流容量产品的布局。

未来国内企业级存储市场有望保持增长态势，公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇。目前公司企业级存储业务发展势头良好，亦是公司业绩增长新动能之一。

17、公司 Lexar（雷克沙）品牌营收增速较快的原因及其未来发展规划？

答：Lexar（雷克沙）在 2023 年的逆势增长，得益于在人才与组织优化、渠道建设、产品创新以及品牌推广等方面的不懈投入。在人才与组织优化方面，2023 年持续加大人才升级与组织优化的力度。通过构筑适合于 toC 消费品牌的组织体系，Lexar（雷克沙）完成了骨干团队的迭代，使团队更加年轻化、高素质化和专业化。这样的团队结构不仅大大提高了工作效率，还为公司的长远发展注入了新的活力。

在渠道建设上，Lexar（雷克沙）充分发挥了中国高效的供应链优势，并结合全球化渠道布局，实现了市场的快速扩张。在美国、欧洲、中东、澳洲等多个区域，Lexar（雷克沙）成功进驻了众多知名零售卖场，如 Costco、Fnac、BestBuy、MediaMart 等，同时在亚马逊等线上零售平台也取得了市场份额的提升，不仅提升了 Lexar（雷克沙）产品的市场覆盖率，还增强了品牌在全球范围内的影响力。

在产品创新及品牌推广面，Lexar（雷克沙）坚持以用户为中心的理念，聚焦真实用户使用场景，通过用户思维引领产品定义和创新。Lexar（雷克沙）在 2023 年进一步大力投入品牌推广。通过明星产品营销、头部媒体传播、全球顶级展会、线上电商营销、头部品牌联合等多种方

	<p>式，成功提升了各区域品牌知名度与关注度，持续增强消费者对 Lexar（雷克沙）品牌的认知度以及提升品牌在高端市场的竞争力。</p> <p>18、公司在智能汽车市场的进展情况？</p> <p>答：公司认为，若考虑 AI 应用在智能汽车落地带来的影响，未来几年车均搭载存储的标准有望超过目前的普遍预期。</p> <p>截至目前，公司车规级 eMMC、UFS 已通过汽车电子行业核心标准体系 AEC-Q100 认证，并已经进入国内二十多家 Tier1 供应链体系。目前公司车规存储芯片处在快速上升阶段，车规级 eMMC 产品，UFS 产品已经批量应用在整车中。</p>
附件清单（如有）	无